

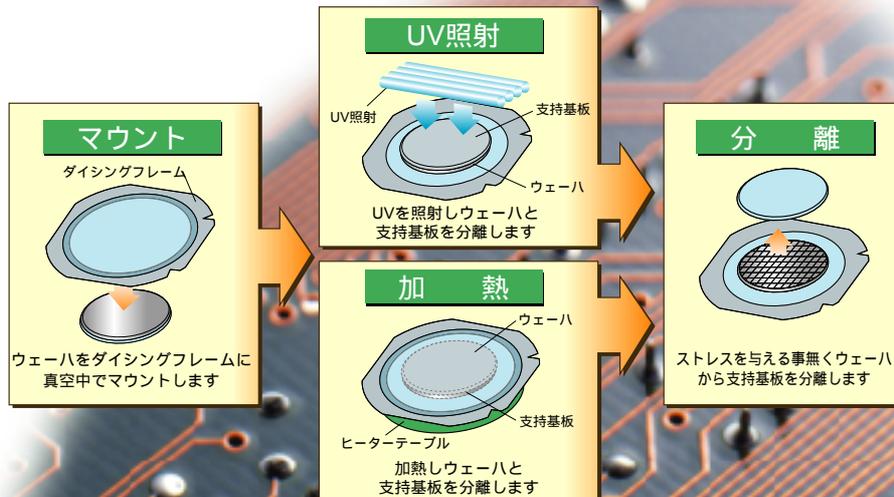
MODEL WSM-200

ウェーハ/支持基板分離装置

概要

本装置は、支持基板に貼付けられたウェーハを真空チャンバー内でマウントし、UV照射（又は加熱）後、支持基板の分離を行います。

超薄厚ウェーハのハンドリング及びマウントはタカトリ独自の吸着エレメント、真空チャンバーの採用によりウェーハにストレスを与えません。



仕様	WSM-200
スループット	40枚/h
対応ウェーハサイズ	6インチ、8インチ
装置寸法	D1,800 × W1,800 × H1,800mm
重量	1,100 (UV200kg含) kg

外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。